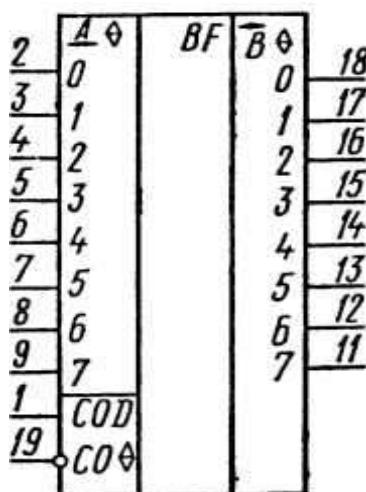


КР1533АП6, КФ1533АП6, ЭКР1533АП6, ЭКФ1533АП6

Микросхемы представляют собой восьмиканальный двунаправленный формирователь (приемопередатчик) с тремя состояниями на выходе. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 2,6 г, 2140.20-В, 4321.20-В.

Назначение выводов: 1 - вход управления информации С0D; 2 - вход/выход А0; 3 - вход/выход А1; 4 - вход/выход А2; 5 - вход/выход А3; 6 - вход/выход А4; 7 - вход/выход А5; 8 - вход/выход А6; 9 - вход/выход А7; 10 - общий; 11 - вход/выход В7; 12 - вход/выход В6; 13 - вход/выход В5; 14 - вход/выход В4; 15 - вход/выход В3; 16 - вход/выход В2; 17 - вход/выход В1; 18 - вход/выход В0; 19 - вход управления третьим состоянием $\overline{C0\Phi}$; 20 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533АП6, КФ1533АП6,
ЭКР1533АП6, ЭКФ1533АП6

Таблица истинности

Входы управления		Операция
C0D	$\overline{C0\Phi}$	
0	0	$B \rightarrow A$
1	0	$A \rightarrow B$
0	1	\diamond
1	1	\diamond

Примечание. \diamond - состояние высокого импеданса.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня:	
- при $I_{\text{вых}}^0 = 12 \text{ мА}$	$\leq 0,4 \text{ В}$
- при $I_{\text{вых}}^0 = 24 \text{ мА}$	$\leq 0,5 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня:	
- при $I_{\text{вых}}^1 = -3 \text{ мА}$	$\geq 2,4 \text{ В}$
- при $I_{\text{вых}}^1 = -15 \text{ мА}$	$\geq 2 \text{ В}$
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения при $U_{\text{n}} = 5,5 \text{ В}$	$\leq 55 \text{ мА}$
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при $U_{\text{n}} = 5,5 \text{ В}$	$\leq 45 \text{ мА}$
Ток потребления в состоянии «выключено» при $U_{\text{n}} = 5,5 \text{ В}$	$\leq 58 \text{ мА}$
Входной ток низкого уровня	$\leq -0,1 \text{ мА}$
Входной ток высокого уровня	$\leq 20 \text{ мкА}$
Время задержки распространения при включении (выключении)	$\leq 10 \text{ нс}$
Время задержки распространения при переходе из состояния «выключено» в состояние низкого (высокого) уровня	$\leq 20 \text{ нс}$
Время задержки распространения при переходе из состояния низкого уровня в состояние «выключено»	$\leq 35 \text{ нс}$
Время задержки распространения при переходе из состояния высокого уровня в состояние «выключено»	$\leq 40 \text{ нс}$

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура

расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.